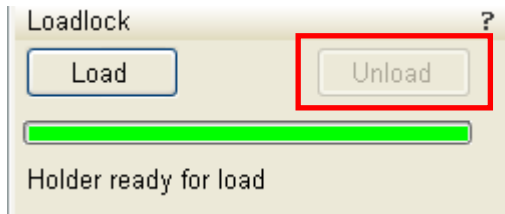


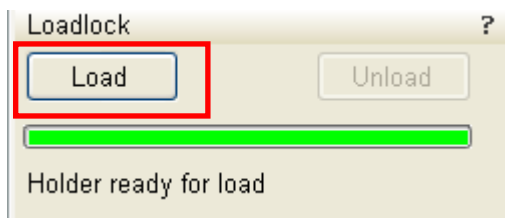
# 聚焦電子束系統標準作業程序

## 1 試片的置放:

i)關閉 E beam/I beam, ii)按 unload loadlock



iii)開 loadlock door 並置入樣品, 按 Load



iv) 確認 chamber 真空度低於  $5 \times 10^{-5}$  mbar



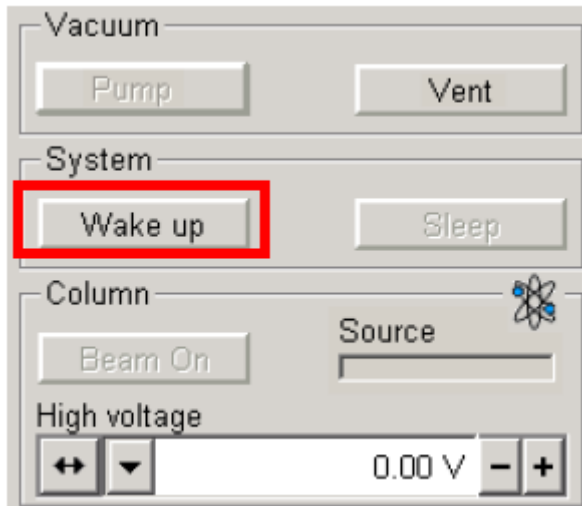
完成



未完成

## 2 電子束及離子束的 ON/OFF

按 Wake up 以開啟 E beam/I beam



### 3 試片/切割點的搜尋

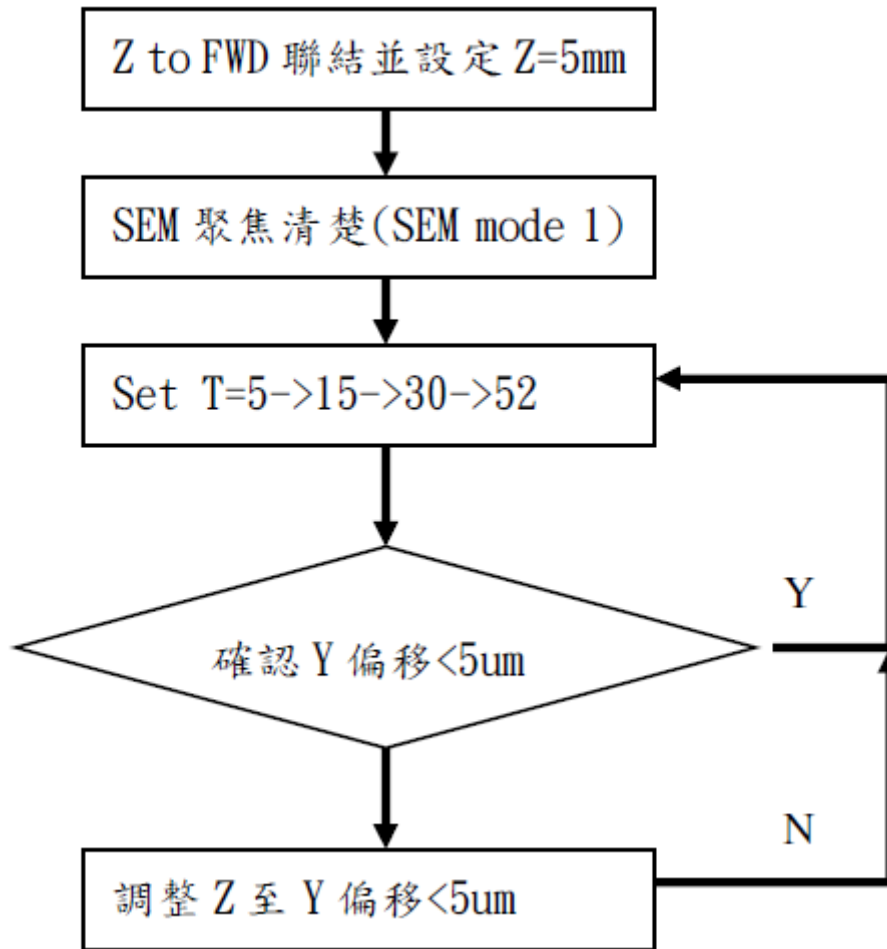
- i) 以低倍率 SEM(mode 1)聚焦並搜尋樣品
- ii)執行 Z to FWD 的聯結, ii)設定 Z=4.25 mm (在 SEM mode)



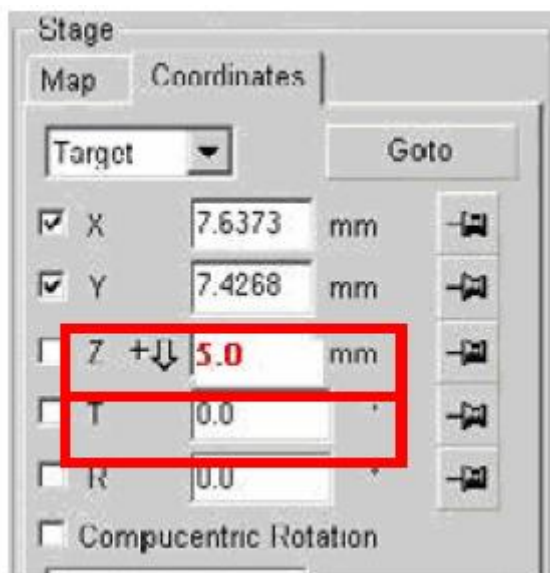
- iii) 將倍率調至約 5000x(scal bar 顯示 5um),並調聚焦(注意:stage 的移動必需配合滑鼠和 QUADE 1-3 in navigator screen)

### 4 試片共焦點(Eucentric height)的設定(SEM mode)

- i) Z 軸的移動必需配合滑鼠和 navigation 頁面



ii) 5 軸座標參數設定



## 5 試片的切割及鍍 Pt 保護層

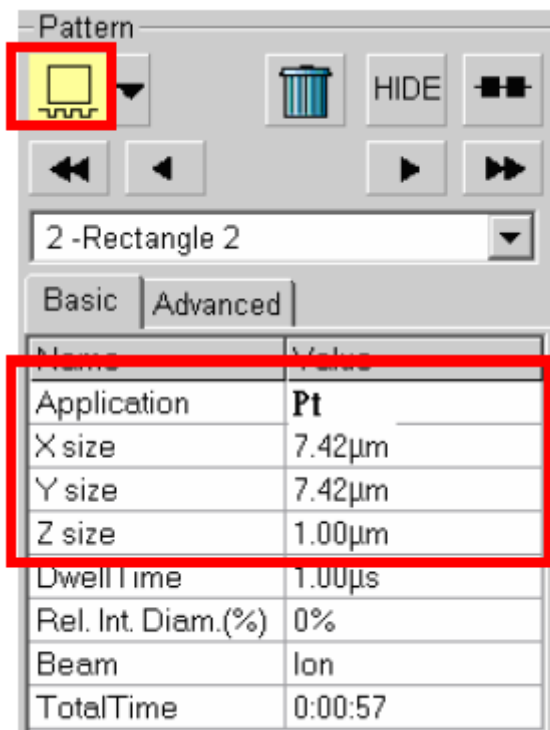
i) 切換至 FIB mode (beam current 選定 30~50pA)

ii) 選 patterning

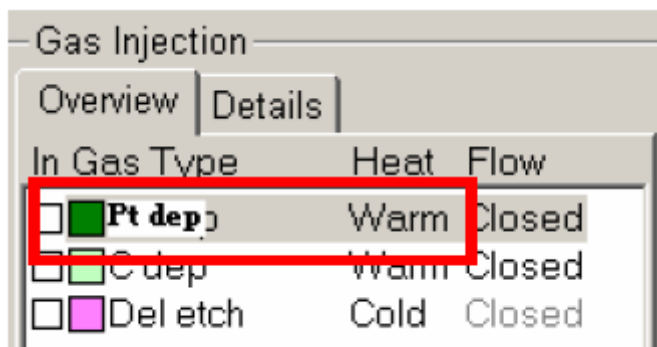


iii) 選定 patterns, 設定 xyz, 選定 material file,

iv) 選定適當的 I beam currents. (電流密度需小於  $10\text{pA}/\mu\text{m}^2$ )



v) 加熱 Pt 及伸針

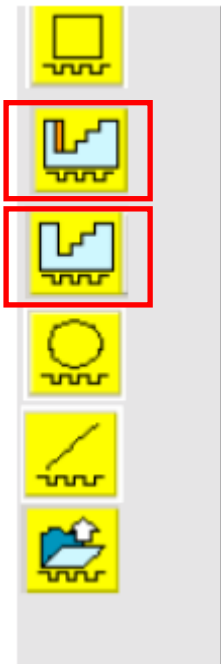


vi) 執行 patterning



vii) 執行 X-section

選定 regular cross section-> cleaning cross section



6 取影像及儲存影像(切換至 SEM mode)

即時影像 

取單張影像 

或按 F2 為預設 photo 設定